# 電子飛跡検出型コンプトンカメラ用 PMT高電圧供給回路開発

#### 京都大学 宇宙線研究室 水本 哲矢

・電子飛跡検出型コンプトンカメラ(ETCC)
 ・シンチレーションカメラ(散乱γ線検出部)
 PMT高電圧供給回路開発について(Open-It)
 ・μ-TPC(コンプトン散乱体&反跳電子検出器)
 μPIC信号読み出し回路について(Open-It)
 ・ETCCのDAQシステムとDAQコントロール回路
 ・今後の課題

#### 2015年7月24日 計測システム研究会@RCNP 大阪大学

# 電子飛跡検出型コンプトンカメラ ETCC





Ar (95%) +isoC4H10+CF4 1気圧



GSOシンチレータアレイ & 64ch PMT

#### electron track





muon track

- ・ガンマ線がコンプトン散乱
- ・ガス飛跡検出器 μ-TPC ⇒反跳電子の3次元飛跡とエネルギー
- ・シンチレーションカメラ

⇒散乱ガンマ線の吸収点とエネルギー

光子毎に到来方向、エネルギーを取得 高いバックグラウンド除去性能 広い視野(~3 str)

シンチレーションカメラ



CLEAR

・シンチレータ信号読み出しにコンパクトで低消費電力の回路を使用
・PMTの信号読み出し回路(Clear Pulse model 80256)は1つにつき6個(2×3)のPSAの信号読み出しを行うことができる。
・PSAの8×8 pixelsは抵抗チェーンで4 chに減らして信号読み出しを行う。
・VME module(Clear Pulse Model 80057)を80256とethernetケーブルで接続して使用。読み出し回路へのthreshold値等の設定や、読み出し回路からのデータのbufferとして使用。
・SMILE-IIでは当初216個のPSA(読み出し回路36セット)を使用することを想定、PMTの高電圧供給回路も小型、コンパクトなものにしたい。

#### SMILE-II実験PMT用 PMT 高電圧供給基板

#### 要請

- 用いるPMTの数が多い(216個)ので
   軽量、コンパクトにしたい。
- PMTにかける電圧値の命令やPMTに流 れる電流値のモニターをしたい。

#### 設計

- DC-HV DCコンバータとして、EMCO
   Q12N-5 を使用。EMCO 1つにつき
   PMT2つに高電圧を供給。
- DAC、ADCを持つマイコンを使用。マイコンを用いて通信も行う。
- ・ HV供給用の基板をPMT後方の信号読 み出し回路に取り付けられるようにする。





地上



### PMT 高電圧供給基板製作

・PCからRS232C通信でどのボードIDの どのchのDAC値を変化させるか命令
・マイコンのDAC出力(0~2.5V)を0~
5Vにし、高電圧供給モジュール(EMCO Q12N-5)に入力、入力電圧に応じて0 ~-1.2kVが出力される。
・高電圧出力のラインに直列に抵抗を入れ、抵抗の両端の電圧をモニターすることで電流値を知る。



PMT高電圧 供給基板

PMT6個分の信 号読み出し回路

> **電源入力**(+6V、+3.3V) マイコンリセット input

RS232C通信用

D-sub9pin

EMCO Q12N-5 (DC-DC Converter)

04mm

PMT用

ディップスイッチ -HV出力×6か所

133mm

PMTアンプ基板に高電圧供給基板を 取り付けた様子。コネクタの干渉等はない。

ワンチップマイコン Atmel社 at32uc3c0512c

ボードID用

JP9 I

**0** 

#### PMT 高電圧供給基板動作チェック



#### マイコンDAC値と出力電圧の関係 (高電圧出力にPMTを2つつけたとき)

PMT測定データの 2次元ヒストグラム(<sup>137</sup>Cs)

#### 64ch (PSA1つ) 分のスペクトル (<sup>137</sup>Cs)



10<sup>2</sup> Energy [keV] 10<sup>3</sup>

→製作した基板は 問題無く動作している として量産を行った。

電流モニターとボードIDの PCへの送信結果(電圧出力に数MΩ ~数十MΩの抵抗をつないだとき)

エネルギー分解能(林栄精器RPH-030 NIMモジュール使用時と高電圧供給基板使用時)



→PMTのHV用GNDとsignal GNDがつながっていて、

PMT HV GND~PMT signal GND~信号読み出し回路GND~PMT高電圧供給基板GND ~0Ω抵抗

の経路で電流が流れているためモニター用抵抗には電流が流れていなかった。

→0Ω抵抗を10uFコンデンサに変更することで対応。



・+5Vのラインに+5Vと異なる電圧(+6Vに近い電圧)が出ていることが判明

・調べると、+6V(基板の外部から入力)→+5V生成用のレギュレータを逆につけている ことがわかった。

・レギュレータのpin1とpin3を入れ替えればよいが、基板設計の修正が必要。+5Vを使用している素子は+6Vを入れても問題ないものを使用しているため現状、pin1とpin3をショートさせることで対応している。



Anode strip番号

Anode strip番号

## µPIC信号読み出し回路





AOUT田力波形 ・これまで使用していたASDチップが生産されなく なったこと、回路の省電力化、コンパクト化を求め て新読み出し回路を開発。 ・KEK測定器開発室で開発されたASICチップ

(FE2006)をもとに低消費電力等の修正を行った チップ (FE2009bal)を開発。FE2009balを8枚の せ、128chのµPIC信号を処理できるµPIC信号読 み出し回路を開発。







#### conventional readout circuit ...

- massive
- takes up a lot of space
- high electric power consumption

->developed new readout circuit

	ASD system (for SMILE-I)	new readout board (for SMILE-II)
ASIC chip transistor type	bipolar transistor	CMOS transistor
strip number per 1 ASIC chip	4	16
power consumption	0.24 W/strip	0.17W/strip

## TPCデータ

・Trigger ID、128ch hit情報(飛跡)、4ch 波形 情報(FADC)含む。

・1イベントごとにTPC、シンチのデータを取得す るシステムではなく、バッファに別々にある程度 ためてからCPUで読み出すシステムのため後で TPC、シンチの同一イベントデータを照合するの にtrigger IDが必要。

 ・128ch hit信号は100MHz clockで1イベント あたり、10µsec分(1024clock分)取得(ドリフ ト時間より十分長い)。飛跡のあるclockのみ保 存。Hitありのデータはすべて保存(↔ SMILE-)。

・4ch波形情報は10bit 50MHz FADCで取得しているが、データ量削減のため8 bit 25MHzのデータに圧縮して取得している(データ圧縮により生じるエネルギー分解能の劣化は問題のない程度)。



TPC 3D reconstructed track (SMILE-II ETCC)



## TPC 3D reconstructed hit data (SMILE-I ETCC)

1.信号の立ち上がりを検出

- 2. 10ns幅でHit したストリップ番号の最大値と最小値を記録
- 3. 10ns幅でanodeとcathodeのhitのコインシデンスを取る

## µPIC読み出し回路修正点1 -Vthの電圧範囲-



 Digital hit信号(荷電粒子飛跡取得用)のthreshold用のVth電圧の範囲が 従来の回路だと0~+3.3V
 →正極性のcathode信号だと問題ない。しかし、負極性のanode信号の場 合、電圧マイナス(thresholdを厳しくする方)に設定することができない。
 →オペアンプを1つ追加してVthの範囲を-2.5V~+2.5Vに変更。

# µPIC読み出し回路修正点2 -Flash ADCのbaseline オフセット調整



 ・Flash ADC (AD9218) のbaseline調整用の10kΩ可変抵抗の電圧値が ねじ回転数と比例でない。
 →可変抵抗以外の回路の影響を受けていると考えられるので、voltage followerを可変抵抗と差動ADコンバータ・ドライバの間に入れる。

# µPIC読み出し回路修正点2 -Flash ADCのbaseline オフセット調整



 ・Flash ADC (AD9218) のbaseline調整用の10kΩ可変抵抗の電圧値が ねじ回転数と比例でない。
 →可変抵抗以外の回路の影響を受けていると考えられるので、voltage followerを可変抵抗と差動ADコンバータ・ドライバの間に入れる。

## SMILE-II ETCC DAQシステム1



・スタンバイのとき、シンチレータでhitが発生したらシンチレータへすぐtriggerを送る。
 ・TPCのドリフト時間より長い8µsec待ってからTPCにトリガーを送り、ring buffer書込み停止、
 ring buffer→FIFOの読み出しを行うと同時にTPCにhitがあるかチェック
 ・TPCにhitが無ければTPC、シンチのデータを消去、スタンバイへ。TPCにhitがあればデータのバッファへの転送開始。TPCデータは転送に時間がかかるが転送中もスタンバイ状態に移行可能。また、バッファ書込みとCPUによるバッファ読み出しは同時に行える。

## SMILE-II ETCC DAQシステム2



# Trigger control unit (TCU)





に接続することが可能。多ピンコネク タで基板間の信号、電源のやり取りを し、1/0基板は必要に応じて枚数を増 減させることができる。

+3.3Vが電源基板から各基板に配ら れる構造で基板の枚数が増えると消 費電力増で電圧降下が起き、動作不 安定になる→電源基板の改良など

#### Performances of SMILE-II FM ETCC



飛跡取得アルゴリズムの変更によりコンプトン散乱 イベントの取りこぼしが無くなったので、検出効率 のシミュレーション値と実験値が合うようになった。



ガスの検討により有効面積 10cm<sup>2</sup> -> COMPTELの感度に到達

x (mm)

x [mm]



### 今後の課題1: VMEを無くす方向へ

µPIC読み出し回路

読み出し回路のSiTCPを利用し、データをTPC通信でVME memory boardを介さずにPCに送るように修正したい(現状SiTCPはDAC設定 値をPCから回路に送信するときのみ使用)。

・高速でデータが送れるように100MbpsからGbps対応のPHYに変更
 ・VME memory boardへデータを送る必要なくなるので68chコネクタを無くす。

#### シンチレーションカメラの読み出し回路

・PMTの高電圧が消費電力大

・消費電力が小さく、コンパクトなMPPCの使用の検討、読み 出し回路の開発(データ取得にVMEを使用しない)。

VMEを無くせば大幅なコンパクト化が実現できる。

### 今後の課題2:新ETCC DAQ -TPC trigger mode-

現在のETCC DAQ mode



・シンチレータにhitがあって、TPCにhitがないイベントがほとんど。シンチレータのhit検出からデータを消去して次にスタンバイ状態になるまでの処理時間(20µsec/event)とそのイベント数でdead timeをほとんど説明できてしまう。

### 今後の課題2:新ETCC DAQ -TPC trigger mode-

新ETCC DAQ mode



・シンチレータに比べてhitレートが圧倒的に少ないTPCでトリガーを発生し、シンチレータのデータがあるか見るようにすればdead timeの大幅な削減が見込める。
 ・シンチレータの信号の有無を後で確認するために波形データを一定時間保持する必要があるが、現状の読み出し回路では不可能。また、TCUのFPGAコードの修正、TPCの飛跡のz座標の導出方法の検討が必要。SMILE-Iのシンチレータ用preamp、VME flashADC等を使用し、TCUを使わずNIMモジュールのgate generator等を組み合わせてDAQを構築し動作実証してみる。

# PMT高圧制御回路、µPIC読み出し回路 使用例(SMILE-II FM ETCC)

#### SMILE-II FM用ETCC



# PMT高圧制御回路、µPIC読み出し回路 使用例(環境ガンマ線測定用ETCC)



ETCCを外に持ち出して環境ガンマ線測定が できるようにSMILE-II実験用に開発してきた電源を 流用し、環境ガンマ測定専用の可搬な ETCCシステムを開発

ETCC、信号読み出し回路

VME、データ収集制御回路

DC/DCコンバータ (±12 V、+6.6 V、+3.3 V、±2.5 V)

Li-Poly充電池 (25 V、100 Ah)

・重さ ~ 100 kg ・消費電力 ~ 100W 1回の充電でおよそ1日動作可能



・MeV γ線天体観測気球実験SMILE-IIに向けて電子飛跡検出型コンプトンカメラ (ETCC)のコンパクトな回路、新データ取得システムの開発を行ってきた。

・シンチレーションカメラ(散乱γ線検出部)

PMT高電圧供給回路

コンパクトな読み出し回路の使用

・µ-TPC(コンプトン散乱体&反跳電子検出器)

µPIC信号読み出し回路

・ETCCのデータ取得システムとtrigger制御回路(TCU)

これらの開発により、SMILE-I ETCC DAQシステムと比べて小型、コンパクト化を実現、 飛跡取得アルゴリズムの変更により、検出器の性能の大幅な向上が実現。

検出器性能: Y. Mizumura et al. JINST 2014, Y. Matsuoka et al., JINST 2015, T. Tanimori et al. ApJ accepted [arXiv:1507.03850v1] など

ハードウェア・DAQ: K. Ueno et al. JINST 2012, および近日submit予定

・ETCCの新データ取得方法の検証、シンチレータの検出器としてMPPCの使用・読み出 し回路開発、µPIC読み出し回路からethernetでVMEを使わずデータを読み出すシステ ムの構築を目指す。